

5-146464-6 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU Headers

Interne TE-Nummer 5-146464-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **6**

Zeilenanzahl: **1**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Ohne Umhüllung
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	6
Zeilenanzahl	1
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

### Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	5000 MΩ
-------------------	---------

### Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

### Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	8.38 mm[.33 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]

	100 – 200 µin
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.381 µm[15 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

### Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	2.21 mm[.087 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

### Montage und Anslusstechnik

Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

### Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

### Abmessungen

Stapelhöhe	10.16 mm[.4 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.4 mm[.055 in]

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

### Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LE7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

## Verpackungsmerkmale

Verpackungs-Typ

Karton

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)  
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)  
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material.  
Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Wellenlötbar bis 265 °C

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **AMPMODU Headers**



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)

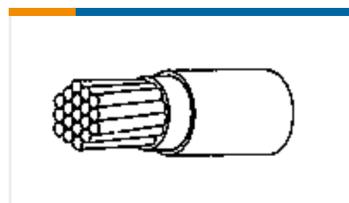


Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:103638-9  
10 MTE HDR SRST LATCH .100CLTE Teilnr.:265263-000  
81044/9-16-2TE Teilnr.:908701-000  
B-106-7502TE Teilnr.:1-5406203-2  
MJ,ASSY,4P,8POS,CAT5,PNL TABS,.1S /TTE Teilnr.:146492-5  
10 MODII HDR DRST UNSHRD STKGTE Teilnr.:146492-9  
18 MODII HDR DRST UNSHRD STKGTE Teilnr.:5-146854-1  
B/A REELED SRST HDR ASSY, 5 AU

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[06 MODII HDR SRST UNSHRD STKG](#)

Englisch

### Datenblätter/ Katalogseiten

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

Englisch

5-146464-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline,  
Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

